

单组分导热填缝硅胶 RH-TCG-635

特色:

- 单组分导热硅凝胶
- 低硬度，低模量，低应力，高回弹
- 加成体系，耐高温，无小分子释放
- 常温固化或加热加速固化
- 低挥发分，挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性，耐热冲击循环

产品组成

- 硅凝胶
- 无机导热填料

产品应用

- 通用性导热凝胶，如计算芯片，服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热

常见性能参数*

产品名称	RH-TCG-635
导热率（瞬态法）W(m·K)	6.3
硬度 Shore 00	55 ± 5
粘度，mPa.s	170000 ± 20000
颜色	淡蓝色
密度 g/m	3.5 ± 0.05
介电强度，KV/mm	≥10
体积电阻率 Ω·cm	≥1.0*10 ¹⁴
可操作时间 min, 25° C	30-60
初步固化时间 min, 25° C	90-120

应用方法

- 自动点胶机

固化条件

- 初固：常温 1.5-2 小时
- 完全固化： 常温 24hr 或加热固化（e.g. 60 摄氏度 1hr， 100 摄氏度 0.5hr）

运输储存条件

单组分包装:

- 200L 铁桶包装
- 低于 2 摄氏度运输
- 保持低温零下储存，最佳使用期限为 2 个月以内

产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内

使用可获得最佳效果。如需其他温度范围，请咨询应用工程师。

其他注意事项

- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触